

生益电子股份有限公司

关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案 的半年度评估报告

生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”或“公司”）认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司结合发展阶段、行业特点、投资者建议等研究制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。

报告期内，公司按照行动方案有力有序推进相关工作的开展，在市场、研发、运营管理、公司治理等多方面持续发力，实施情况和实施效果主要如下：

一、聚焦印制线路板主业，持续优化产品布局

报告期内，公司坚持“多业并重”的战略方针，持续优化产品结构，通讯网络、计算机/服务器、汽车电子的产品结构更加均衡。

在通讯领域，公司与国内通讯客户建立了紧密的合作关系，成功实现了 5G-A 产品的规模化生产与批量交付，进一步巩固了公司在通讯领域的市场地位。公司在通讯 PCB 技术领域进行深度研发与创新，持续进行技术升级与产品优化。

在计算机及服务器领域，受益于市场复苏的积极态势，公司的服务器产品订单量显著增长，与全球客户的业务合作不断深化，公司在 AI 领域用 PCB 产品的出货量实现了显著的同比增长。同时，公司自主研发的 400G 与 800G 高速传输 PCB 产品也迎来了市场的认可，发货量实现提升。目前，公司正积极与客户携手针对下一代产品进行前瞻性研发。在卫星通讯这一高技术领域，公司已与多家行业领军企业展开深度合作，共同推进相关技术的创新与优化。

在汽车电子领域，公司成功通过了多家知名车企的认证，并在项目开发上取得了突破性进展，其中 800V 高压充电技术项目、车载域控制器项目均已获得客户的认证，部分项目已经定点。公司的汽车电子产品销量继续增长，保持了稳步提升。

二、持续加强研发投入，保持技术领先优势

公司目前拥有 PCB 产品制造领域的完整技术体系和自主知识产权，截至 2024 年 6 月 30 日，公司已经获得了 249 项发明专利，制定了 19 项行业标准及规范。报告期内，公司持续加大对核心技术的深度研究和布局，新获得发明专利 6 项、新制定发布标准 3 项、新发表技术论文 6 篇，以持续提升的核心竞争力，维护公司在行业内的技术领先地位。

报告期内，公司持续加强研发投入，在行动方案中 8 个研发项目有序开展的基础上，新增 7 个研发项目，聚焦网络、卫星通讯、无线通讯、消费电子、高端服务器、智能汽车电子、新能源等领域的相关技术研发，以保持公司技术领先的优势。主要项目及其开展情况详见下表：

序号	项目名称	应用领域	研发目标	研发进展
1	高密组装高端印制电路板的技术研究开发	网络领域 服务器领域	研究开发双面阶梯图形（含阶梯金手指）、逐次压合 HDI 结构+阶梯槽图形等各种结构的三维组装，复杂结构的高端高密线卡板，提升公司在图形计算、高速网络服务器等高端线路板领域的竞争力，并实现产业化。	开发出采用耐热阻胶隔离膜制作双面阶梯板的工艺技术。缩短制作周期，降低制作成本，消除形状、尺寸和结构设计对阶梯板制作工艺的限制。提升公司在图形计算、高速服务器等高端产品上的技术能力。
2	400G 及以上高端光模块印制电路板的研究开发	网络领域 服务器领域	研究开发面向电信光通讯网络及数据中心架构网络应用的 400G 及以上传输速率的高速光模块印制电路板产品，攻克 HDI 复合光器件异形结构设计、精细 Wire Bonding 图形及金手指精密加工等技术难点，并实现产业化。	实现 QSFP-DD 及 OSFP 封装类型 400G 以上高速光模块 PCB 量产，800G 光模块产品批量样板交付；具备 ≥ 4 阶及 Anylayer 高密互联、外层 3/3mil 精细 Wire Bonding 图形加工以及阶梯槽、埋铜、软硬结合等复杂结构产品制作能力。
3	面向车载毫米波雷达的印制电路板的研究开发	汽车领域	研究开发面向车载毫米波雷达的印制电路板产品，提升公司在汽车智能驾驶领域的市场竞争力，并实现产业化。	完成对毫米波雷达主流技术调研；设计研究方案和改善方案，针对工艺难点进行优化改善。
4	nR-nF-nR 特殊结构高多层软硬结合板工艺的研	网络领域 服务器领域 消费电子领域	研究高阶 HDI 埋铜块、局部盖子保护、点胶、贴屏蔽膜、air-gap 等特殊结构高多层软硬结合板制作技术，攻克不对称结构翘曲、高多层软	开发出复合高阶 HDI 埋铜块、局部盖子保护、点胶、贴屏蔽膜、air-gap 等特殊结构的高多层软硬结合板制作工艺，解决了不对称结构翘曲、高

	究开发		硬结合板可靠性等技术难关，并实现产业化。	多层软硬结合板可靠性等技术障碍，已实现批量生产。
5	EGS 服务器高可靠性印制电路板的研究开发	服务器领域	研究开发高性能（损耗要求<0.96@16GHz）、低成本的材料应用于 EGS 平台产品的新技术，可靠性、BGA 平整度、翘曲等均能满足产品要求，提升公司在高端服务器领域的市场竞争力，并实现产业化。	完成优化压合条件、棕化处理条件以及电镀参数、钻孔参数、各工序涨缩尺寸控制对产品可靠性及尺寸稳定性的影响研究。
6	面向智能驾驶汽车的信息传感及能源动力控制 PCB 的研究开发	汽车领域	研究不同材料 1500V 高压 CAF 的 PCB 制作工艺及失效模式潜在影响，完成面向智能驾驶汽车的信息传感及能源动力控制 PCB 产品的研制，并实现产业化，提升公司在车载高压平台 PCB 制作方面的市场竞争力。	完成部分材料在 1500V 高压下 CAF 测试及失效分析，研究在制作条件基本相同的条件下，不同材料在 1500V 高压下 CAF 测试的性能差异，提升车载高压平台 PCB 制作选材技术能力。
7	面向能源产品的耐压超 4242V 的印制电路板的研究开发	新能源领域	研究开发面向能源产品的耐压超 4242V 的印制电路板产品，提升公司在光伏新能源领域的市场竞争力，并实现产业化。	通过优化铜箔选择、叠构设计、图形设计的方法提高 2oz 厚铜板的耐高压及长期可靠性性能；正在对 4oz-5oz 产品的耐高压及长期可靠性性能影响研究。
8	高密精细线路高阶互联印制电路板的研究开发	消费电子领域 汽车领域	实现 anylayer HDI 高密互联产品结构的设计制作，具备各层 0.35mm pitch BGA 夹横竖绕线的精细线路制作能力，提升我司在消费类产品及可穿戴等产品上竞争优势，并实现产业化。	实现 0.35mm pitch 夹线的线宽间距为 50 μm/40 μm 的精细线路制作和 5 阶 HDI 的制作。
9	应用于卫星互联网的印制电路板的研究开发	网络领域 卫星通讯领域	研究卫星互连星载 PCB 技术，提升公司在星地互连网络领域技术开发能力，提升在卫星通讯领域的竞争力，并实现产业化。	完成互连星载 PCB 技术中的任意层互联技术，天线图形精度控制技术研究；正在研究高多层不对称产品翘曲控制技术。
10	车载 800V 高压系统平台 PCB 的研究开发	汽车领域	研究开发面向车载 800V 高压系统平台的印制电路板产品，提升公司在新能源汽车领域的市场竞争力，并实现产业化。	进行新能源汽车 800V 高压平台的 PCB 产品开发。
11	下一代网	网络领域	研究对高速信号传输、信号	完成 1.6T 以太网主板制作材

	络技术 1.6T 以太网主板的 研究开发	服务器领域	完整性、可加工性、可靠性超 高要求的印制电路板产品， 抢占下一代 1.6T 以太网产品 市场、确保我司长期在核心 网络主板加工的技术优势。	料的配方研究；完成新构建 的 1.6T 容量即单通道 224G 通孔过孔方案测试模型研 究；完成 1.6T 以太网主板 PCB 各关键指标的仿真和分解。
12	Power Next 高端 服务器印 制电路主 板的研究 开发	服务器领域	研究开发 Power Next 高端服 务器高可靠性印制电路板产 品，促使高端服务器的国产 化，并实现产业化。	完成材料评估选择及实施方 案策划，同步完成国产化材 料组合方案试板加工制作。
13	5.5G 无线 通信产品 的研究开 发	通讯领域 消费电子 领域	研究开发 5.5G 无线通信印制 电路板产品，攻克技术难点， 并实现产业化。	Mid loss/low loss low CTE 板材多区域埋铜混压技术： 开发 4 种板材，适用多区域埋 铜块混压工艺，满足可靠性 及焊接稳定性需求。大尺寸 AAU 稳定性技术：正在开展板 材选用、层压参数及缓冲材 料替换方案研究。大尺寸埋 铜块密集排板工艺技术：已 通过板材选择、叠构搭配及 层压参数等方面研究，解决 小间距埋铜块介厚不均及可 靠性难点。
14	面向超级 计算机主 板的印制 电路板 的研究开 发	网络领域 消费电子 领域	研究开发面向超级计算机主 板的印制电路板，满足更严 苛的翘曲度与平整度要求， 并实现产业化。	完成超级计算机主板开发的 前期预研工作，目前正研究 采用不同叠构设计或调整材 料稳定性进一步改善翘曲。
15	应用于云 服务超算 的高端 AI 服务器的 研究开发	服务器领域	研究开发应用于云服务器超 算的高端 AI 服务器的高端印 制电路板，并实现产业化。	完成大尺寸厚板电镀深镀能 力、对准度、图形精度、平整 度、插损等技术能力研究。

三、深化组织运营管理，提升综合竞争力

1、建立健全人力资源政策，激发组织与员工活性

基于外部形势、行业竞争以及公司发展需求，报告期内，公司持续推进人力资源政策的建立健全，激发组织活性与员工活力。

在激励与约束方面，公司通过目标管理牵引促进人效提升，并完善了相应的激励机制与制度，在此基础上对公司薪酬结构进行变革优化，加强薪酬与个人绩

效的关联，提升员工的工作动力、满意度和活力；同时，公司进一步完善了绩效管理制度，通过强绩效管理引导员工发挥自身价值、创造价值，提升员工的积极性和获得感。

在组织队伍建设方面，公司持续完善培训与发展体系，重视后备人才的培养和发展，通过金牌班组长助力基层管理者实现管理能力升级。报告期内，公司重点开展匠星计划，推动车载专项培训、英语专项培训落地，持续提升员工专业能力，助力业务成功。

在重点项目方面，基于业务发展需要，建立健全海外用工、外派管理制度，支持公司海外用工需求，保障公司海外战略的执行。

在文化建设方面，通过“点赞”活动，深度挖掘标杆人物，讲好生益故事，发挥榜样力量，完善 QCC 文化圈，自下而上深入开展持续改善，营造良好的组织氛围。

2、建立充分竞争的商务环境，保证采购安全和推动成本节省

公司持续完善供应链管理体系，通过 RPA 机器人流程自动化，实现采购计划自动化。通过 SRM 供应商管理系统，实现内外部的高度协同。通过集中各子公司的需求及统一议价，充分发挥集采优势，降本增效。通过建立敏捷、柔性、高效协同的供应链管理体系，实现信息流、物流、资金流、业务流和价值流的有效集成和控制，打造了客观、公正、阳光、多元化的采购体系。

报告期内，公司在全球合作供应商约 700 家，其中超过 95%来自国内，关键物料认可多家供应商，确保供应安全。公司持续与核心供应商保持战略合作关系，报告期内，公司已组织供应商开展超过 300 次的培训及技术交流，已开展约 50 次的供应商现场审核，已导入约 10 项新物料，进一步保障供应链安全，建立充分竞争的环境，为降本增效保驾护航。

3、提升自动化和智能化水平，提高生产效率

公司坚持“聚焦重点、提升效能”的策略，以数智驱动企业转型升级，提升产品创新与管理能力。

报告期内，各项自动化、数字化、智能化重点项目均按计划顺利推进，其中：基于数据中台、使用内存数据库技术搭建了 PCS 级产品追溯平台，实现核心功能并逐步完善相关功能，为质量管理数字化提供分析支持。东城三厂 85%的核心流

程上线使用全自动智能排产平台，实现各工序智能协同作业，显著提升工厂制造自动化和智能化水平。与国内外多家大模型 AI 厂商进行深入交流，并通过多种方式提升内部用户的数字素养和 AI 使用能力。RPA 机器人流程自动化项目作为重点项目顺利推进，已组建跨部门的专门团队进行需求分析及蓝图设计，并已完成 10 个流程的开发及上线，助力工作质量和效率的持续提升。

公司在数字化和智能化方面的努力已经取得初步成效，为全面持续的数字化转型和智能化升级打下坚实基础。公司将继续加大技术投入，深化数字化建设，完善现有项目，并探索新的技术应用，以实现更高效、更智能的生产和管理。

4、进一步强化质量管理，保证公司产品质量竞争力

报告期内，公司持续强化“零缺陷”管理，进一步优化并推进零次废员工及质量优胜奖管理评审和监督机制，树立员工一次做对的理念。同时各工厂全员推进 QCC 小组活动开展，推动全工序零缺陷项目有效落地，提升工厂整体质量管理水平。

在推进质量管理机制落地方面，质量中心定期组织质量会及质量案例研讨与交流，梳理改善重点，评估改善效果。年初组织质量规划研讨与发布，明确公司整体的质量重点工作与方向，有效指引各工厂开展相应的质量改善活动。同时，公司持续推进举手机制、质量红线机制以及质量管理闭环监督机制的有效落地，组织年度集团质量基础知识的测试与质量月活动的开展，组织工厂质量一致性的对标与提升，不断优化质量激励规范，推动全员参与质量改善，提升质量意识和质量效益。

在推进质量改善专项与质量平台建设方面，在严进、过程管控、严出、客户服务等方面加强管理。严进方面，持续优化来料检验方法与标准，提升检验手段，利用管理 IT 化不断推动供方质量提升与内部质量稳定，严把供方质量绩效管理。过程管控方面，持续推动工厂 PCS 级追溯管理平台以及质量自主预警平台的搭建与推广应用，进一步精准识别和控制风险；推动 SPC 项目的有效开展，提升过程质量稳定性；组织梳理各工厂各流程防呆防错机制对标与系统化；建立客户 SPEC 要求模块化与应用，建立检验要求下发系统，推动客户要求在各工序的有效识别与监控；持续梳理优化工厂主要业务流程，提升工作质量与效率。严出方面，重

点推动各工厂质量检验有效性提升，建立质量检验地图；持续跟进高风险缺陷的机理研究与问题解决及系统防呆。

报告期内，公司质量表现稳步提升，获得多家关键客户颁发的“质量优秀协作奖”“最佳质量奖”“合作共赢奖”“优秀供应商”等奖项。

四、聚焦公司重大项目，有力有序推进项目实施

1、有力推进东城四期项目，有序扩大产能规模

东城四期项目是公司实现产品和技术升级的重要举措，尽管受到行业波动的影响，四期项目仍按计划有序推进，在产能提升、质量改善以及新客户认证方面取得了不错的成绩。东城四期三厂（HDI 工厂）产品阶数及比例均持续提升，高阶 HDI 实现客户认证及批量量产；东城四期四厂（软硬结合板工厂）的产能及产值也稳步提升，在光模块产品市场开发中取得进展。报告期内，公司持续推动东城四期项目提产以及目标产品的导入，进一步提升高阶高密 HDI 产能和软硬结合板产能及市场占有率，提升项目盈利能力。

2、稳步推进吉安二期项目，结合市场环境扩充汽车 PCB 产线

吉安二期项目定位中高端汽车电子产品，以全面扩充公司在汽车电子产品方面的产能，进一步增强汽车领域的竞争力。项目于 2022 年 8 月份启动厂房建设，2023 年 9 月份完成厂房封顶，截至目前，吉安生益二期基建项目厂房主体外架已全部拆除，基建已进入收尾阶段。工艺及公共设施规划基本完成，相关的技术和设备选型已初步调研完成，预计 2025 年 12 月达到可使用状态。公司围绕项目定位和项目计划推进项目实施，同时，公司将高度关注市场变化情况，如市场环境一旦变化，将随即响应并快速扩充产能，以抓住市场机遇，实现公司规模的稳健扩张。



3、系统布局泰国新建生产基地项目，推动项目启动建设

自 2023 年公司完成泰国公司设立、境外投资备案、签署土地购买协议、转移土地权等重要里程碑事项后，报告期内，公司综合海外战略、行业发展、客户需求等多方因素，组建了泰国生益筹建团队，全面研究工厂规划、工艺布局、筹建计划等。泰国生益预计在 2024 年下半年正式动工，公司将有序推进项目建设，确保项目按时、按质、按量完成。同时，公司将积极关注市场动态，围绕客户需求和趋势持续完善项目建设，助力公司提升在全球市场的综合竞争力。

五、持续完善公司治理，推动公司高质量发展

1、深入贯彻落实独立董事制度改革

公司有序落实独立董事制度改革，修订了《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作细则》等相关制度，并严格按照相关制度要求执行。公司已为独立董事们开设专属办公室，便于独立董事开展每年不少于 15 日的现场工作，并指定了董事会办公室作为沟通服务机构，专门负责组织交流、会议议案材料编制、信息反馈等工作。公司及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，为独立董事工作提供便利条件，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

2、持续深化内部审计工作

报告期内，审计部结合年度审计计划及公司实际业务发展需求，有效完成了每季度的募集资金使用情况审计、吉安生益 2023 年进出口业务审计及海关 AEO 高级认证企业标准符合情况审计、四期及研发中心工程及设备固定资产管理情况审计，正在进行生产循环审计及生产制造系统管理人员任中审计。

通过审计，确认公司不存在募集资金管理违规情形；促进吉安生益顺利获得海关 AEO 高级认证；确认四期及研发中心的投资项目整体内控制度设计和执行是合理有效的，未发现公司存在重大或较大的内控缺陷，对细节管理方面提出改善建议，并将审计建议与泰国生益项目负责人和吉安二期项目负责人进行交流，提前细化管理措施，促进项目管理持续优化。

六、加强投资者沟通交流，完善投资者意见征询与反馈

报告期内，公司积极接听投资者专线，及时回复“上证 E 互动”平台以及投资者交流邮箱上投资者关注的问题，在定期报告后以视频+文字互动的形式举办

投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读，并在“上证路演中心”以图文简报的形式对财务报告进行可视化展示，在“生益电子”公众号上发布一图读懂年报、一图读懂社会责任报告，在生益电子官网设置投资者关系专栏，并下设股东回报、最新公告、财务数据、公司研报、公司调研五个专项，方便投资者以各种渠道了解公司。

七、完善投资回报机制，启动实施股份回购

报告期内，基于对公司未来发展前景的信心、公司长期投资价值的认可及切实履行企业的社会责任，为完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股份。截至2024年4月30日，公司已实际回购公司股份15,518,757股，占公司总股本831,821,175股的比例为1.87%，回购成交的最高价为10.80元/股，最低价为8.52元/股，累计已支付的资金总额为人民币149,972,150.77元（不含印花税、交易佣金等交易费用），公司完成回购事项。

根据回购股份方案，本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。公司将在相关公告披露后三年内按照本次回购股份的用途实施。如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销并相应减少注册资本，公司总股本将相应减少，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

八、强化管理层与股东利益的共担共享约束以及“关键少数”的责任

1、强化高级管理人员激励及约束

为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，根据《生益电子股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等有关法律、法规及公司内部制度的规定，结合公司的发展阶段，制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。围绕《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司中期发展战略、2024年重点工作以及行业情况等制定高级管理人员2024年绩效考核指标，以充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展。

高级管理人员2024年绩效考核设置了资产收益率、销售收入、核心客户开发进度完成率、技术创新、成本、人效等指标。上述考核要求锚定公司经营状况、

成长性、盈利能力等与投资者利益紧密相关的指标，并设定了具有一定挑战性的考核目标，有助于提升公司整体发展质量，增强投资者回报。

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司启动了 2024 年限制性股票激励计划，方案设置了有挑战性的业绩目标和约束条件，有助于激发核心人员活力，促进核心人员稳定，推动公司实现更高质量的发展。

2、控股股东自愿延期解禁

公司于 2023 年 10 月 16 日收到公司控股股东广东生益科技股份有限公司关于自愿延期解禁限售股的说明。控股股东认为，公司主营业务为印制电路板的研发、生产与销售，公司的主要客户是通信设备、网络设备、计算机/服务器、汽车电子、消费电子、工业控制、医疗、航空航天等行业优质客户。作为电子产品生产制造的关键环节，公司通过不断提升技术水平和扩大产能，使产品质量和技术能力不断满足下游客户电子产品的需求与变化。公司在建项目多且进展良好，未来几年将陆续投产，新项目投产后，行业地位将明显提升，行业影响力将明显增强。基于对公司价值的认可和未来发展的信心，控股股东决定延期解禁所持全部限售股 6 个月，截至本行动方案披露日，上述股份已经解除限售。

3、部分股东自愿承诺未来六个月不减持公司股份

公司于 2023 年 10 月 16 日收到公司股东东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司关于自愿承诺未来六个月不减持公司股份的说明。公司股东东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，上述股东自愿承诺，自承诺函签署之日起 6 月内（2023 年 10 月 16 日至 2024 年 4 月 15 日）不减持其所持有的公司股份。

报告期内，上述股东严格履行自愿承诺内容，承诺期限内未减持公司股份。

4、5%以上股东国弘投资增持公司股份

公司于 2023 年 10 月 27 日收到公司持股 5%以上股东东莞市国弘投资有限公司的告知函，东莞市国弘投资有限公司拟自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内，通

过上海证券交易所允许的方式，增持本公司股份，增持金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元，资金来源为国弘投资自有资金和自筹资金。自增持计划披露之日起，截至 2024 年 4 月 29 日，国弘投资已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 1,814,666 股，占公司总股本的 0.22%，合计增持金额约为人民币 2,068 万元，本次增持计划已实施完毕。

九、其他事宜

报告期内，公司按照行动方案细化深化工作举措，相关工作有序推进落实，实现营业收入 19.73 亿元，比上年同期增加 24.64%。归属于上市公司股东的净利润 0.96 亿元，比上年同期增加 903.93%。

下半年，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注印制电路板主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

生益电子股份有限公司

2024 年 8 月 28 日